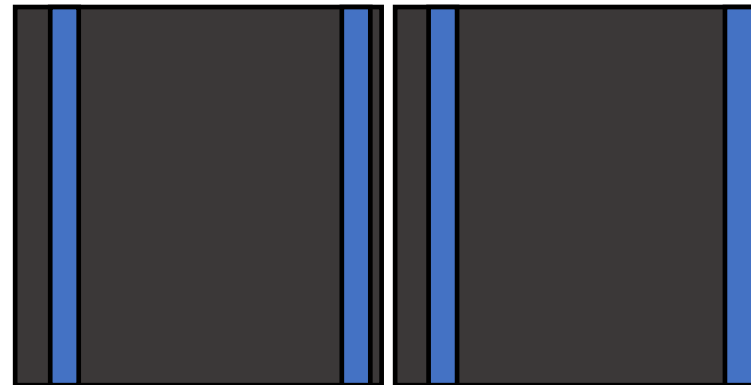
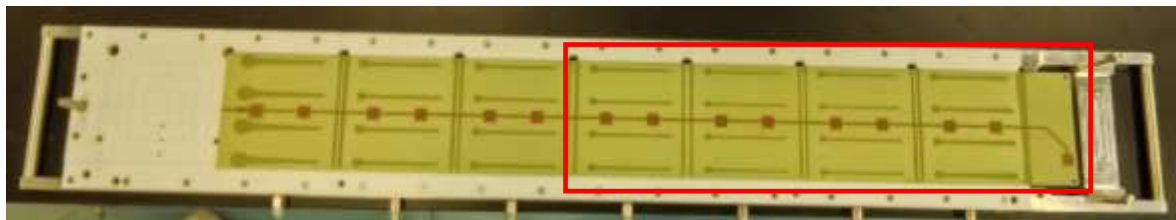


HERD Wirebonding进展

金梁程龙、王昊洋、唐远平、潘逸阳

2026.7.10

LP dummy ladder 键合情况

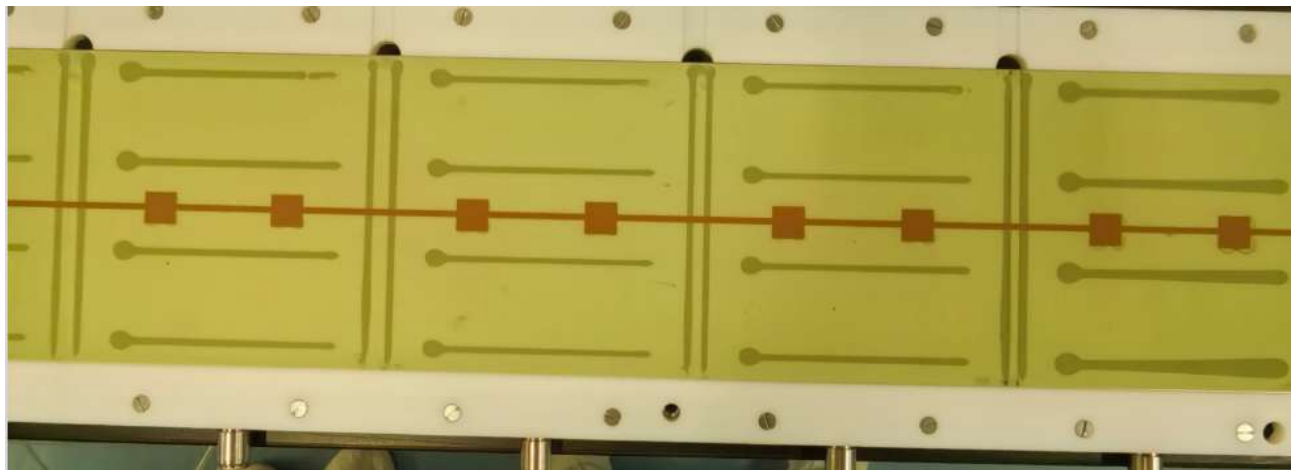


➤ 点胶实验

- 第1-2, 2-3组, 右侧pad胶水距离边缘0 mm
- 第3-4, 4-5组, 右侧pad胶水距离边缘1 mm

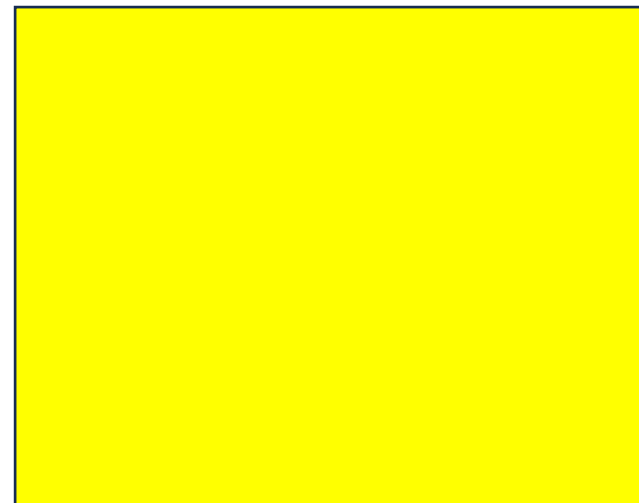
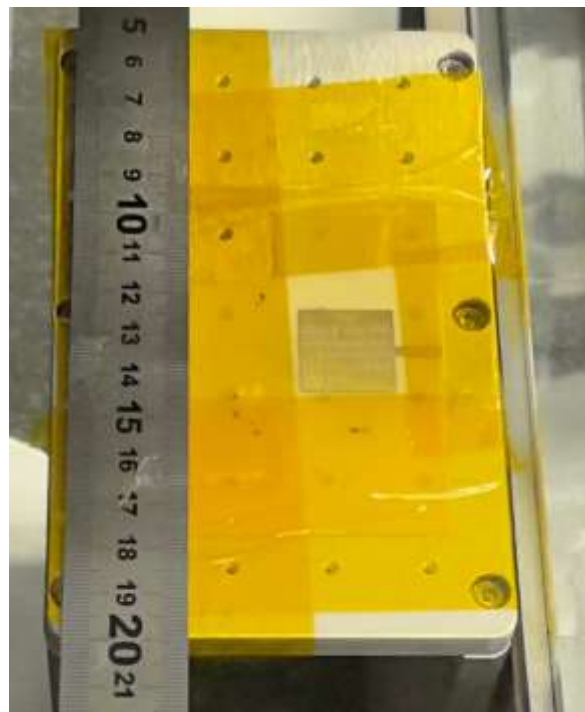
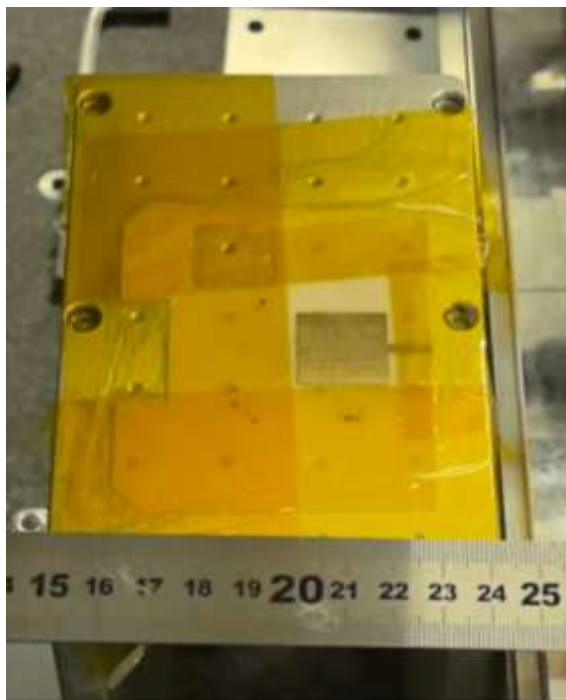
➤ 键合情况

- 使用原来程序, 1-2, 2-3多数键合不成功
- 多组矩阵调参, 成功键合3列740根



- 不可分析因素：基于Dummy sensor质量问题与当前环境湿度，无法定性是胶水位置问题
- 可以确定一点：如果真LP ladder开始键合有问题，可以通过调参提高键合效率
- 将点胶位置修正0.5 mm
- 后续按照安排完成LP、TP、LZ、TZ以及对应的SFE板键合
- 完成剩余PID的键合

键合 Offbond 截线金手指需求



8 mm

10 mm

- 金手指需求
- Pcb厚度和SBB一致，但可以整面镀金手指
- 方案1：尺寸可以做成8 mm*10 mm
- 方案2：长度宽度可以很长，后期可以按需求裁剪